

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 26 年 6 月 5 日 (2014.6.5)

【公開番号】特開 2013-12561 (P2013-12561A)
 【公開日】平成 25 年 1 月 17 日 (2013.1.17)
 【年通号数】公開・登録公報 2013-003
 【出願番号】特願 2011-143739 (P2011-143739)
 【国際特許分類】

H 0 1 G 4/232 (2006.01)

H 0 1 G 4/30 (2006.01)

H 0 1 G 4/252 (2006.01)

【F I】

H 0 1 G 4/12 3 5 2

H 0 1 G 4/30 3 0 1 B

H 0 1 G 1/14 V

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 4 月 21 日 (2014.4.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

主要な表面と、主要な裏面と、2つの端面と、2つの側面を有する略直方体のセラミック素体の両端面に、前記端面を覆う端面部分と前記主要な表面、前記主要な裏面および前記2つの側面に回り込んで形成された回り込み部分とを有する端子電極を備えた積層セラミック電子部品であって、前記端子電極は、前記端面部分及び前記回り込み部分に凹部が形成されており、前記端面部分の凹部の幅 W_1 は前記素体の幅 W_0 の 30% 以上であり、かつ、前記凹部の深さ t_1 は前記端面部分の最大厚さ t_{max1} の 10% ないし 50% であり、前記回り込み部分の凹部の幅 L_1 は前記回り込み部分の長さ L_0 の 30% 以上であり、かつ、前記回り込み部分の凹部の深さ t_2 は前記回り込み部分の最大厚さ t_{max2} の 10% ないし 40% であることを特徴とする積層セラミック電子部品。

【請求項 2】

前記端子電極がディップ塗布法によって形成されたことを特徴とする請求項 1 に記載の積層セラミック電子部品。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

主要な表面と、主要な裏面と、2つの端面と、2つの側面を有する略直方体のセラミック素体の両端面に、前記端面を覆う端面部分と前記主要な表面、前記主要な裏面および前記2つの側面に回り込んで形成された回り込み部分とを有する端子電極を備えた積層セラミック電子部品であって、前記端子電極は、前記端面部分及び前記回り込み部分に凹部が形成されており、前記端面部分の凹部の幅 W_1 は前記素体の幅 W_0 の 30% 以上であり、かつ、前記凹部の深さ t_1 は前記端面部分の最大厚さ t_{max1} の 10% ないし 50% であ

り、前記回り込み部分の凹部の幅 L_1 は前記回り込み部分の長さ L_0 の 30% 以上であり、かつ、前記回り込み部分の凹部の深さ t_2 は前記回り込み部分の最大厚さ t_{max2} の 10% ないし 40% であることを特徴とする積層セラミック電子部品によって達成される。